

# 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—7 页

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕961号

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州中欣晶圆半导体股份有限公司（以下简称中欣晶圆公司）管理层编制的截至2025年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中欣晶圆公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中欣晶圆公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

## 二、管理层的责任

中欣晶圆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中欣晶圆公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，中欣晶圆公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了中欣晶圆公司截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二六年三月二十三日

# 杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意杭州中欣晶圆半导体股份有限公司股票公开转让并在全股转系统挂牌及定向发行的函》（股转〔2025〕2334号），本公司向特定对象发行人民币普通股股票20,333.33万股，发行价为每股人民币3元，共计募集资金61,000万元，公司本次募集资金净额为61,000万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕300号）。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2025年12月31日余额	备注
招商银行杭州拱墅支行	571912713210001	2,000.00		募集资金已使用完毕，并于2025年12月17日销户
中国工商银行股份有限公司杭州分行	1202021129800306641	20,000.00		募集资金已使用完毕，并于2025年12月16日销户
中信银行杭州玉泉支行	8110801012303235823	19,000.00		募集资金已使用完毕，并于2025年12月18日销户
交通银行秋涛路支行	331066150015003136864	20,000.00		募集资金已使用完毕，并于2025年12月16日销户

开户银行	银行账号	初始存放金额	2025年12月31日余额	备注
合计		61,000.00		

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

## 三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

## 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2025年6月20日，公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》等与本次发行相关的议案，自该次股东会会议后，截至2025年10月21日，公司以自筹资金预先支付货款、支付员工工资等，合计金额291,389,477.14元，公司使用募集资金290,000,000.00元进行置换，具体情况如下：

募集资金用途	以自筹资金预先投入金额（元）	本次拟使用募集资金置换金额（元）
预先支付货款、支付员工工资等	291,389,477.14	290,000,000.00
合计	291,389,477.14	290,000,000.00

## 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

### 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### 八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的使用。

### 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

二〇二六年三月二十三日



附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：61,000.00						已累计使用募集资金总额：61,000.00				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：0 无						各年度使用募集资金总额： 2025 年：61,000.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,004.05	50,000.00	50,000.00	50,004.05	4.05	不适用
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		不适用

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金在银行账户中产生的利息收入扣除手续费后的净额

附件 2

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位：杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	